

## 【 ランチョンセミナー募集要項 Sponsorship Opportunities 】

1. 名称: 第 10 回 DIA 医療機器開発シンポジウム  
Event: 10th DIA Medical Device Symposium in Japan
2. 期間: 2024 年 11 月 26 日(火)  
Date: Tuesday, November 26, 2024  
(予想参加者数: 100/ Expected number of participants: 100)
3. ランチョンセミナー : 40 分 × 1 枠  
11 月 26 日(火) ①11:40-12:20 ※多少前後する可能性あり  
  
Luncheon Seminar: 40-minute seminar (Only 1 slot available)  
Tuesday, November 26 ①11:40-12:20 ※Subject to change.
4. 参加者情報: ランチョンセミナーの参加者情報を、各スポンサー企業にご提供します。  
Details of attendees participating in the luncheon seminar will be shared with the sponsoring companies.
5. スポンサー費用: 1 枠 330,000 円(税込)に加え、参加者の弁当代、ならびに Web 参加者に参加特典として配布する Starbucks eTicket(500 円/1 人)の実費をご負担いただきます。  
Fee: JPY 330,000 (inclusive of 10% consumption tax). The sponsoring company will cover the costs of attendee's lunch box fees and provide a Starbucks eTicket (JPY 500\_ to each luncheon seminar in-person attendee.
6. スポンサー企業概要:  
スポンサー企業の簡単な紹介文および連絡先を、事前に参加者にメールで案内いたします。  
下記の要領にて、貴社の概要を **11 月 15 日(金)正午**までに DIA Japan([japan@DIAglobal.org](mailto:japan@DIAglobal.org))までお送りいただきますようお願い申し上げます。  
スポンサー企業名 (英語ならびに日本語の両方)、紹介文 (日本語で 220 字、もしくは英語で 100 ワード以内)、ご連絡先 (ご担当者名、E メールアドレス、電話番号を半角英数字にてご記載ください)

Sponsor's Profile: A brief introduction (up to 100 words in English or 220 characters in Japanese) and contact information (company name, email address, phone number) of sponsoring companies will be included in the pre-event email sent to registrants. Profiles should be sent to the DIA Japan office via e-mail ([japan@DIAglobal.org](mailto:japan@DIAglobal.org)) by **Friday, November 15**.

その他、ご不明な点等ございましたら、DIA Japan までご相談ください。 [japan@DIAglobal.org](mailto:japan@DIAglobal.org)  
Should you have any questions, please contact to the DIA Japan Office.